

版图设计委托业务情况说明

北京大学设计多颗芯粒，包括面向芯粒互连的 64Gbps 以上全双工收发芯粒、面向光电共封装的 35GHz 以上高带宽高增益大摆幅硅光驱动器芯粒、面向光电共封装的 35GHz 以上高带宽低噪声跨阻放大器芯粒、以及 56GHz 带宽的光信道缺陷补偿芯粒等。这些芯粒全部为高性能模数混合集成电路，需要进行全定制版图设计。现计划从【集成电路高精尖创新中心】项目中付 35 万元用于版图设计开发。

合肥特芯信息科技有限公司是一家专业集成电路版图委托设计高新技术企业，成立于 2019 年 08 月，是安徽特芯电子科技有限公司的全资子公司。该公司专注于版图委托设计，组建了有丰富版图设计经验的工程师团队，已经与近一百家设计公司开展版图委托设计服务业务，具有丰富的设计经验，可以实现设计目标。

现将集成电路版图设计开发项目委托合肥特芯信息科技有限公司，特此说明。

项目负责人：李和军

日期：2025.5.21

